

证券代码： 301369

证券简称： 联动科技

佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 投 2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	1、天风证券 骆奕扬； 2、中银资管 周喆； 3、广东竣弘投资 陈翔。
时间	2024年6月12日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理兼董事会秘书 邱少媚女士； 2、证券事务代表 梁韶娟女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>（1）主营产品介绍</p> <p>公司成立于1998年，一直专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。公司具备较为完善的产品线，主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备，此外还有相应配件、维修服务等。公司的半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。</p> <p>成立后，公司推出首款激光打标设备，主要用于半导体分立器件的打标。得益于优异的产品性能，迅速得到了半导体封测客户的认可。而后凭借激光打标设备积累的客户资源、封测产线应用经验以及工业控制技术，公司自2003年起即开始进入分立器件测试系统领域，通过多年深耕封测行业的经验与技术积累，目前已经拥有自主研发的功率半导体及小信号分立器件测试系统产品包括 QT-</p>

3000/4000/5000/6000/8400 系列，涵盖小信号分立器件及中高功率半导体测试，包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅、SiC 和 GaN 第三代半导体等，以及功率模块的晶圆测试、KGD 测试及出厂测试，并已实现了产品的国际化布局。特别是公司 QT-4000 系列功率器件综合测试平台，主要针对功率器件测试，能满足高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求，能够实现半导体器件直流参数测试项目和动态参数测试项的一对一数据合并，同时能够分别实现小信号分立器件和中大功率器件的多工位并行测试要求，带来测试精度、测试效率及数据分析管理效率的大大提高，顺应了市场变化趋势，深受市场主流功率半导体客户的认可，是公司销量较高的产品之一。

随着功率器件 CP 测试（晶圆测试）的需求逐渐增多，为了提升测试效率，客户对测试系统的并行测试能力不断提高。针对功率半导体和第三代半导体器件测试带来的新的测试需求，公司推出了新产品 QT-8400 系列功率测试平台，主要用于 IGBT 及第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件和晶圆测试及功率模块的全性能测试，能够满足电动汽车、新能源等工业领域日益增长的测试需求和新的应用场景。

（2）产品应用环节

公司产品主要应用于半导体生产前道工序中的晶圆测试环节，以及后道工序中框架或裸晶激光打标、KGD 测试、成品测试、激光打标/视觉检测等环节。KGD 测试是新的工艺技术环节，随着制造成本的提升和合封器件的应用，功率器件 CP 测试（晶圆测试）的需求逐渐增多，半导体测试越来越注重每一环节的可靠性，从而保证良率、降低成本。这些新的市场变化也将为测试设备企业带来更大的业务需求及市场空间。

经过多年的发展，公司已在佛山、上海、成都、无锡、苏州、马来西亚等代表性市场区域建立起推广及服务网点，业务领域覆盖华南、华东、西北、东南亚等主要市场。近几年，随着新能源、电动汽车等行业快速发展带来的新的应用领域的发展，公司的客户结构也有发生一些变化，以前以半导体封测厂商客户为主，现在以 IDM 模式的功率半导体厂商客户为主。

公司拥有一支优秀的人才队伍，研发人员占公司员工总数 30%以上，至今仍不断发展壮大。

二、问答环节

1、请问公司 2024 年一季度经营情况如何？公司今年二季度的和全年展望？

回复：2024 年一季度，公司收入端出现改善，由于市

场的不确定性，二季度及全年情况目前无法预测，但整体来看当前行业去库存周期已接近尾声，正逐渐走出低谷期，开始看到客户需求逐步恢复的迹象。随着未来整体市场环境逐步好转及需求端的边际企稳，并且伴随着行业技术的不断进步和新能源、电动汽车产业快速发展所带来的新兴应用领域市场的持续增长，长期来看，显示行业趋势向好，仍将呈现较强的成长动能。今年我们保持谨慎乐观的态度看待行业发展趋势，现阶段产品需求正在结构性修复，但市场发展也存在一定的不确定性。

2、 请问公司在 KGD 测试领域的布局和进展？

回复：KGD 测试是新的工艺技术环节，主要针对车规类 SIC 芯片，目前公司在 KGD 测试领域布局进展顺利，客户反应积极，测试机已批量出货。

3、 请问公司 QT-8400 系列功率半导体测试系统目前订单情况？

回复：公司 QT-8400 系列测试机主要用于 IGBT 及第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件和晶圆测试及功率模块的全性能测试，目前已有部分知名半导体厂商的订单，实现一定的批量出货，正在逐步放量的阶段。

4、 请介绍公司产品毛利率情况？

回复：2023 年度，在公司主要产品半导体自动化测试系统、激光打标设备的产品销售中，高电压、大电流等单价较高的半导体自动化测试系统以及紫外脉冲、高功率等单价较高的激光打标设备销售份额占比较高，产品销售结构相较 2022 年发生变动。在 2023 年行业周期下行，下游整体面临去库存和产品降价压力的大环境下，为了稳定市场份额，公司给予了客户更积极的产品定价，但固定成本刚性支出，使得整体产品售价涨幅小于成本涨幅，综合导致公司综合产品毛利率小幅下降 3.54 个百分点。如若未来行业复苏不及预期或出现停滞或竞争加剧，公司仍将面临产品毛利率下滑的压力。如若未来行业逐步复苏，市场环境持续向好，叠加新兴应用领域的快速发展以及公司在大功率器件/模块和第三代半导体器件/模块测试领域的竞争优势，将有利于公司产品毛利率的稳步提升。

5、 请问目前公司大规模数字集成电路测试系统的研发进度？

回复：目前公司大规模数字集成电路测试系统的产品研发还在推进中，正在进行硬件架构的搭建和完善。

6、 公司预计今年订单增量主要是来自哪些产品？

	<p>回复：主要来自公司功率半导体测试系统 QT-4000 系列、QT-3000 系列、QT-8400 系列等产品，KGD 测试领域相关的测试应用也将是公司重点拓展的方向之一。</p> <p>7、请问公司未来投资并购计划？</p> <p>回复：公司注重企业资金的使用效率，关注合适的投资发展机会，在合适的时机，寻求产业整合度较高的并购标的做一些上下游或横向并购的尝试。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 12 日